

REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS E
INTERNACIONALES

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE Y RENISON UNIVERSITY COLLEGE.

SANTIAGO, 000422 . 15.01.19.

VISTOS: El DFL. N° 149 de 1981, del Ministerio de Educación, y
la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

La importancia para la Universidad de Santiago de Chile de
promover la cooperación académica e interinstitucional e internacional y fomentar las relaciones bilaterales de carácter
académico.

RESUELVO:

APRUEBESE el convenio, suscrito entre la Universidad de
Santiago de Chile y Renison University College, Canadá, con fecha 28 de diciembre de 2017 y cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO ESPECÍFICO

Entre

RENISON UNIVERSITY COLLEGE
240 WESTMOUNT ROAD NORTH, WATERLOO, ONTARIO, CANADÁ, N2L 3G4

Y

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TRAVÉS DE SU FACULTAD DE INGENIERÍA (FING)
AV LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 3363, SANTIAGO DE CHILE, CHILE

ARTÍCULO I. PARTES Y FINALIDAD

La Universidad de Santiago de Chile (UdeSantiago de Chile) a través de su Facultad de Ingeniería (FING) y el Renison University College (RENISON), un colegio afiliado de la Universidad de Waterloo, cooperarán en los esfuerzos para establecer y conducir proyectos académicos, programas y / o actividades, los cuales apoyarán las Iniciativas de internacionalización académica de cada institución.

Los detalles específicos de las actividades de cooperación/colaboración que se lleven a cabo, incluido el uso de terceros y la asignación de apoyo y recursos, se establecerán en un acuerdo escrito entre las partes que se ejecutará en una fecha posterior, antes del inicio de cualquiera de esas actividades. Este Acuerdo específico es un acuerdo independiente entre UdeSantiago de Chile a través de FING y RENISON, y no forma parte de ningún otro acuerdo que pudiera ser generado entre UdeSantiago de Chile y la Universidad de Waterloo.

ARTÍCULO II. COOPERACIÓN CON TERCERAS PARTES

UdeSantiago de Chile a través de FING y RENISON reconocen que ambas instituciones pueden optar por cooperar con terceras partes, que pueden tener capacidades y recursos, que beneficiarán y apoyarán proyectos, programas y/o actividades académicas mutuamente acordados entre UdeSantiago de Chile a través de su FING y RENISON. Las terceras partes pueden incluir pero no se limitan a; Sedes/sucursales, facultades, institutos, centros, organizaciones y departamentos. UdeSantiago de Chile a través de su FING y RENISON identificarán cualquier cooperación con terceros relacionados con proyectos, programas y / o actividades académicas mutuamente acordadas.

ARTÍCULO III. DURACIÓN, TERMINACIÓN

Este Acuerdo específico es por un período inicial de cinco (5) años a partir de la fecha de la última firma, la cual puede ser extendida por el mutuo consentimiento por escrito de las partes. Este Acuerdo específico puede ser terminado por cualquiera de las partes sin responsabilidad en cualquier momento y por cualquier razón. Cualquier modificación requerirá la aprobación por escrito del Decano de FING de la UdeSantiago de Chile, y el Presidente de RENISON, o sus designados.



Todos los acuerdos y/o contratos firmados entre UdeSantiago de Chile a través de FING y RENISON para proyectos, programas y/o actividades académicas específicas como resultado de este Acuerdo específico serán listados como Apéndices y tendrán sus propios términos y condiciones independientes con respecto a la duración y sin estar limitado a lo expresado en este Acuerdo específico.

ARTÍCULO IV. La propiedad intelectual que derive de los proyectos y trabajos realizados en conjunto, bajo el marco de este convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los convenios específicos que firmarán las partes, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos proyectos y actividades.

Las partes convienen que podrán utilizar en sus funciones académicas la información y resultados derivados de las actividades realizadas en el presente instrumento, tomando las medidas necesarias para la adecuada protección de eventuales patentes, información reservada y otros activos de propiedad intelectual que correspondan.

ARTÍCULO V. Las personas relacionadas con este Convenio quedarán sometidas a las normas vigentes en la Institución en donde desenvuelven sus actividades, sin que adquieran, bajo ninguna circunstancia, vínculo laboral con la Institución Receptora. La selección de personas para trasladarse, por cualquier concepto, de una a otra Institución, se realizará según las normas de la Institución de origen, sin perjuicio de su aceptación por la Institución de destino.

ARTÍCULO VII. Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio y sus anexos se solucionará por negociación directa entre las partes. En cualquier momento una parte podrá proponer a la otra su modificación.

ARTÍCULO VIII. SIGNATARIOS DESIGNADOS.

La representación de la Dra. Wendy L. Fletcher, Presidenta y Vicecanciller de Renison University College, está debidamente autorizada por el Consejo de Administración y la constatación de documentos y estatutos de Renison para firmar este acuerdo en nombre de Renison y que la firma del Presidente en el este acuerdo en nombre de Renison obligará Renison a ello.

La representación del Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, Rector de la Universidad de Santiago de Chile, consta en el Decreto Supremo del Ministerio de Educación de Chile N° 341 de fecha 14 de Agosto de 2014.

La representación legal del Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, Msc. Juan Carlos Espinoza Ramirez consta en el Decreto Universitario N°1766 con fecha 27 de junio del 2014 que lo nombra Decano, y la delegación de facultades que lo autorizan para firmar en su calidad de Decano consta en el Decreto Universitario N° 668 de 1988.

Universidad de Santiago de Chile
Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363
Santiago de Chile, Chile

Renison University College
240 Westmount Road North
Waterloo, Ontario, Canada
N2L 3G4

Aprobado por:

Aprobado por:

Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector
Fecha

Dr. Wendy L. Fletcher
Presidente y Vice-Canciller
Fecha

Juan Carlos Espinoza
Decano
Facultad de Ingeniería
Fecha

APÉNDICE A – INGLÉS GENERAL – PROGRAMA DE SERVICIOS PARA ENRIQUECIMIENTO EN INGLÉS GENERAL, INGENIERÍA, EMPRENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA PROVISTO POR RENISON PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA (FING) DE LA UDESANTIAGO DE CHILE

El Apéndice A identifica todas las disposiciones de servicio acordadas mutuamente de RENISON a los estudiantes de la FING- Ude Santiago de Chile, que asisten al programa de Inglés General, Ingeniería, Emprendimiento y Tecnología, de cuatro semanas de inglés intensivo de duración.



1. PERIODO DEL PROGRAMA

- Sesión I de invierno 2018: 8 Enero – 2 Febrero 2, 2018 (4 semanas)

A los estudiantes se les permite llegar 1 día (s) antes de la fecha de inicio del programa. Estudiantes que desean llegar antes tienen que pagar un costo adicional por el alojamiento provisto. FING-Ude Santiago de Chile determinará qué sesión del programa prefiere.

2. NÚMERO DE ESTUDIANTES. RENISON aceptará un máximo de 20 estudiantes por sesión en FING-Ude Santiago de Chile.

3. RESPONSABILIDADES DE RENISON. Proveer los siguientes servicios contratados del Apéndice A a los estudiantes de la FING- Ude Santiago de Chile que asistan al programa de Inglés General: Ingeniería, Emprendimiento y Tecnología:

- 80 horas de cursos intensivos de inglés (20 horas por semana) en habilidades de lectura, escritura, gramática, comprensión oral y expresión oral.
- Cartas de admisión para cada estudiante registrado.
- Transcripción y certificado de finalización.
- Cobertura del Plan de Seguro Médico Universitario (UHIP) por 4 semanas.
- Servicio de recogida y entrega de ida y vuelta entre el Aeropuerto Internacional Pearson y Renison University College
- Las siguientes actividades complementarias fuera del aula:
 - Tour a la Facultad de Ingeniería y visita interactiva al Sedra Design Center para conocer los equipos de diseño de estudiantes.
 - Tour a la planta de fabricación de Toyota.
 - Visita a una incubadora de negocios local.
 - Tour a la Facultad de Ciencias y Observatorio Gustav Bakos.
 - Presentación del Centro de Negocios, Emprendimiento y Tecnología Conrad.
 - Acto de Bienvenida con grupos de conversación de estudiantes de Ingeniería

4. RESPONSABILIDADES DE FING-UESANTIAGO DE CHILE: Como institución asociada, la FING de la Ude Santiago de Chile, es responsable de:

- Selección y registro de estudiantes calificados para el programa
- Recoger los pagos de los estudiantes inscritos y remitir los pagos del programa grupal a RENISON.
- Organizar vuelos internacionales y apoyar a los estudiantes con cualquier visa requerida para entrar a Canadá
- Organizar alojamientos apropiados en Canadá para los estudiantes registrados por la duración del programa.

5. SUJECIÓN A LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS CHILENA: En consideración de la calidad de Universidad Pública de la Universidad de Santiago de Chile, todas las disposiciones del presente anexo deberán regirse estrictamente por lo dispuesto en la Ley Chilena numero 19.886 sobre Compras Públicas.

6. HONORARIOS CARGADOS A FING-UESANTIAGO DE CHILE POR RENISON UNIVERSITY COLLEGE. RENISON cobrará a Ude Santiago de Chile una cuota de programa de \$ 1841.00 dólares canadienses (CAD) por estudiante registrado para el programa.

El costo del programa incluye:

- Costo de la matrícula y material didáctico
- Cuota de servicios estudiantiles (tarjeta de identificación de Waterloo y pase de autobús urbano)
- Seguro de salud por 4 semanas
- Recogida y entrega en aeropuerto de ida y vuelta
- Actividades Complementarias fuera de las clase identificadas en la Sección 3 del Apéndice A.

Una factura de grupo se emitirá a la Ude Santiago de Chile 4 semanas antes de la fecha de inicio del programa. El pago debe ser hecho por la FING-Ude Santiago de Chile a RENISON antes de la fecha identificada en la factura del grupo.

7. TASAS CARGADAS A ESTUDIANTES DE LA UDESANTIAGO DE CHILE POR RENISON. RENISON cobrará a los estudiantes de la FING- Ude Santiago de Chile por cualquier viaje opcional de fin de semana a destinos turísticos en el sur de Ontario.

8. SISTEMA DE CALIFICACIÓN. Los estudiantes son calificados en cada curso en una escala de 0 a 100 dependiendo de su desempeño en la clase. Los estudiantes también tendrán un promedio de asistencia clasificado en una escala de 0 a 100. Los estudiantes recibirán su informe de calificaciones y certificado de finalización el último día del programa. FING-Ude Santiago de Chile recibirá una copia electrónica del informe de calificaciones de cada estudiante de RENISON 1 semana después de que el programa haya finalizado oficialmente.



9. CONTACTOS DE PROGRAMA DESIGNADOS. Las siguientes personas se enumeran como contactos designados de Renison University College y FING- Universidad de Santiago de Chile en relación con el programa GEAR:

- Sr. Ralón Nazareth, Especialista en Marketing y Reclutamiento, Instituto de Lengua Inglesa, Renison University College. E-mail: ralon.nazareth@uwaterloo.ca
Teléfono: 1-519-884-4404 Ext. 28720
- Mrs. Anoek van den Berg, Directora Adjunta, Alianzas Internacionales, Proyecto Nueva Ingeniería para el 2030, Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago, Chile.
E-mail: anoek.vandenberg@usach.cl Teléfono: + 56-227-180313

Las siguientes firmas corresponden al Apéndice A de las disposiciones de servicio del programa ejecutadas por RENISON y la FING de la de Santiago de Chile.

Universidad de Santiago de Chile
Av Libertador Bernardo O'Higgins 3363
Santiago de Chile, Chile

Renison University College
240 Westmount Road North
Waterloo, Ontario, Canada
N2L 3G4

Aprobado por:

Aprobado por:

Juan Carlos Espinoza
Decano
Facultad de Ingeniería
Fecha

Dr. Wendy L. Fletcher,
Presidente y Vice-Canciller
Fecha

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,

Dr. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, Rector

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

Saluda a usted,


GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL

JMZ/CJR/GDLB
IP: 80045

DISTRIBUCIÓN:

- 1 Rectoría
- 1 Contraloría Universitaria
- 1 Dirección de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales
- 1 Oficina de Partes
- 1 Archivo Central

